

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-029

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2018年末，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的20%，根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至2018年末，公司经审计借款余额为81.80亿元，较公司2017年未经审计借款余额58.04亿元（人民币，下同）增加23.76亿元。

2017年未经审计净资产为100.47亿元。

2018年1-12月累计新增借款余额占2017年未经审计净资产的23.65%。

二、新增借款的分类披露

公司2018年末较2017年末各类借款余额变动情况如下：

（一）短期借款：增加27.45亿元；

（二）一年内到期的非流动负债：减少0.88亿元；

（三）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：增加0.03亿元；

（四）长期借款：减少2.84亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为公司正常经营发展需要而发生的，截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日